

合肥晶合集成电路股份有限公司

2024 年第一季度业绩指引的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩指引情况

（一）业绩指引期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

（二）业绩指引情况

经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）业务及财务部门初步核算和预测，预计 2024 年第一季度实现营业收入 207,000.00 万元至 230,000.00 万元之间，预计综合毛利率在 22%至 29%之间。

二、上年同期业绩情况

2023 年第一季度（未经审计），公司实现营业收入 108,976.63 万元，综合毛利率为 8.02%。

三、本期业绩变化的主要原因

1、随着行业景气度逐渐回升，下游消费电子行业去库存情况取得一定的成效，市场需求逐步释放。公司积极调整销售策略，与下游客户维持稳定合作，产能利用率及销量较上年同期有较大增长。

2、公司不断致力于丰富自身产品结构及强化自身技术能力，在 55nm-28nm 制程及车用芯片研发上持续加大投入，取得了显著的成果。55nm CIS 及 55nm TDDI 产品实现量产，进一步增强公司产品市场竞争力。另外，公司车用 110mm 显示驱动芯片已通过公司客户的汽车 12.8 英寸显示屏总成可靠性测试，加快推动公司产品向汽车市场领域拓展。

四、风险提示

目前 2024 年第一季度尚未结束，本次业绩指引为前瞻性陈述，是公司业务及财务部门基于自身专业判断进行的初步核算和预测，尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩指引内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日